

Bydgoszcz, dnia 25.08.2022

Edurewolucje sp. z o.o.
ul. Braci Bazańskich 5/1
85-799

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Zapytania ofertowego: „Zakup licencji oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB do prowadzenia zaawansowanych prac projektowych i analitycznych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.”

Pytanie 1.

W związku ze specyfikacją towarzyszącą zapytaniu z dnia 18.08.br., a w szczególności punktowi:

- Obsługę projektów wielopłytkowych z zarządzaniem połączeniami między nimi;

chcielibyśmy zgłosić pytanie, czy akceptowalna jest funkcjonalność polegająca na możliwości weryfikacji dopasowania między oddzielnymi płytami pcb na poziomie konektorów (i zgodności sygnałów w tych konektorach) łączących oddzielne płyty pcb w interfejsie graficznym 3D Design.

Oryginalny opis tej funkcjonalności (za dokumentem Layout 3D Design Guide):

|| EN

The ability to display the netlines between connectors in a multi-board assembly helps you confirm if two connectors have matching pin/net assignments so they connect properly. If the net assignments in the Connector Mapping dialog box do not match, you must change the assignments either in the current PCB design or in the model file for the PCB model that you import.

|| PL

Możliwość wyświetlania linii sieci między złączami w zespole wielopłytkowym pomaga potwierdzić, czy dwa złącza mają pasujące przypisania pinów/sieci, dzięki czemu łączą się prawidłowo. Jeśli przypisanie sieci w oknie dialogowym, mapowanie złącza nie są zgodne, należy zmienić przypisania w bieżącym projekcie PCB lub w pliku modelu importowanego modelu PCB.

Odpowiedź:

Tak, wskazana funkcjonalność jest akceptowalna w ramach wskazanych cech oprogramowania.

Treść niniejszego punktu została zmieniona na:

Obsługę projektów wielopłytkowych z zarządzaniem połączeniami między nimi. W minimalnym zakresie: umożliwiającą weryfikację dopasowania między oddzielnymi płytami pcb na poziomie konektorów (i zgodności sygnałów w tych konektorach) łączących oddzielne płyty pcb.

Zmiany w zapytaniu ofertowym naniesione w dniu 25.08.2022:

W punkcie drugim odnoszącym się do specyfikacji zmieniono:

Podpunkt:

1. Szczegółowe cechy oprogramowania:

Podpunkt „Obsługę projektów wielopłytkowych z zarządzaniem połączeniami między nimi”

Obowiązująca wersja:

Obsługę projektów wielopłytkowych z zarządzaniem połączeniami między nimi. W minimalnym zakresie: umożliwiającą weryfikację dopasowania między oddzielnymi płytami pcb na poziomie konektorów (i zgodności sygnałów w tych konektorach) łączących oddzielne płyty pcb.

2. Pozostałe wymagania Zamawiającego:

Treść przed zmianą:

Licencja na 1 stanowisko. Licencja ważna bezterminowo z subskrypcją na aktualizacje programu i wsparcie techniczne przez 12 miesięcy. Dokumentacja do programu (podręcznik) w języku polskim. Możliwość instalacji przez Internet ze stron producenta oraz nośnik DVD lub USB do instalacji „off-line”.

Obowiązująca wersja:

Licencja na 1 stanowisko. Licencja ważna bezterminowo z subskrypcją na aktualizacje programu i wsparcie techniczne przez 12 miesięcy. Dokumentacja do programu (podręcznik) w języku polskim **lub angielskim**. Możliwość instalacji przez Internet ze stron producenta oraz nośnik DVD lub USB do instalacji „off-line”.

Szczegóły dostępne w aktualnej wersji zapytania ofertowego. Zmiany zostały zaznaczone poprzez pogrubienie czcionki.

W związku z powyższym ostateczny termin składania ofert wydłużono do 01.09.2022 do godziny 10:00.